

4979

華星光通科技(股)公司
LUXNET Corporation
法人說明會
2023Q2
Earning Release

2023 Sep 14

免責聲明

本簡報及同時發佈之相關訊息可能包含對於未來展望的表述，本公司不暗示、不聲明亦不保證其內容之正確性或可靠性，使用者應自行判斷與承擔風險。該類表述是基於對現況的預期，但同時受限於已知或未知風險或不確定性的影響。因此實際結果將可能明顯不同於表述內容。有些資訊可能受未來不確定性因素影響，致使與原先本公司對於未來前景的說明迥異。

除法令要求外，公司並無義務因應新資訊的產生或未來事件的發生，主動更新對未來展望的表述。

本簡報資料中所提供之資訊不代表本公司、產業狀況或後續重大發展的完整論述。此簡報及其內容未經本公司書面許可，任何第三者不得任意取用。

簡報 大綱

公司簡介

技術及製程能力

經營實績

市場趨勢及未來展望

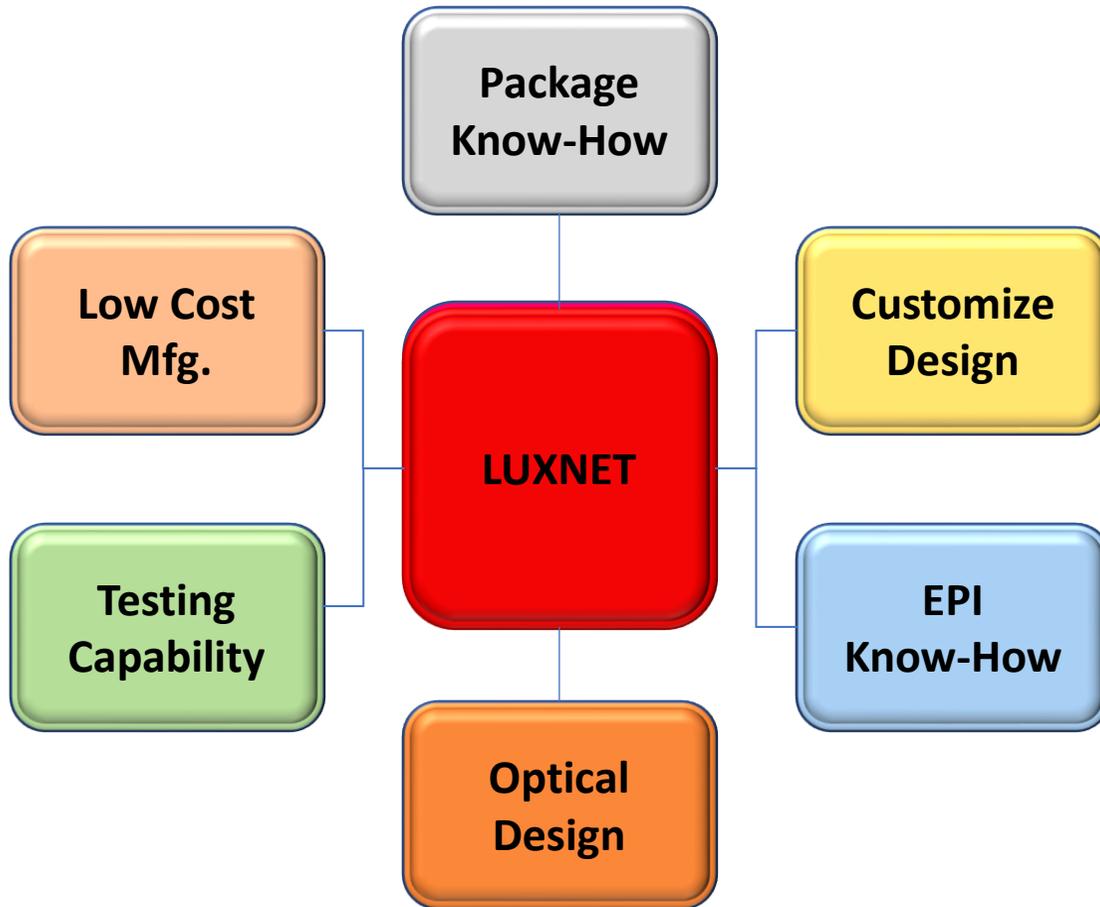
Q & A

公司簡介

成立日期	2001/11/15
實收資本額	新台幣1,323百萬元
管理團隊	簡惠敏董事長 曾俊霖總經理
所在地	桃園市中壢區合江路6號
員工人數	455人(研發人員27人)
主要產品及服務	<ul style="list-style-type: none">• Diode (LD & PD), Optical Engine and Transceiver• OEM & ODM / Foundry Business



技術及製程能力-優勢定位



- Comprehensive know-how from chip design, package assembly to module manufacturing
- Advanced optical packaging know-how
- Precision optical and electro-mechanical assembly
- Lower cost manufacturing and testing capability

技術及封裝能力(一)

Wafer
Fab

- 2-3 inches wafer
- Photolithography
- RIE, PECVD, RTA
- Metal deposition
- Wafer Lapping

Die
Fab

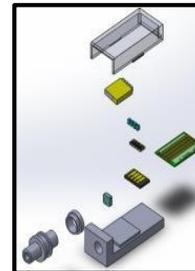
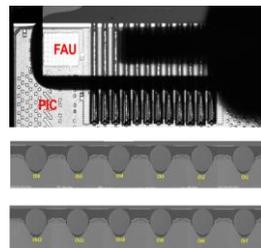
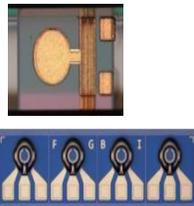
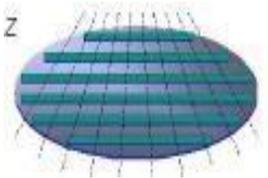
- Cleaving and dicing
- High quality optical coating
- Testing and sorting

Packaging

- To-CAN packaging
- Box/Butterfly packaging
- Chip-on-carrier
- CoC BI
- Chip-on-PCB
- Feature process
 - laser assisted bonding
 - high-precision placement (<3um)
 - Flip-chip bonding
- Fiber Array Attachment

Assembly &
Testing

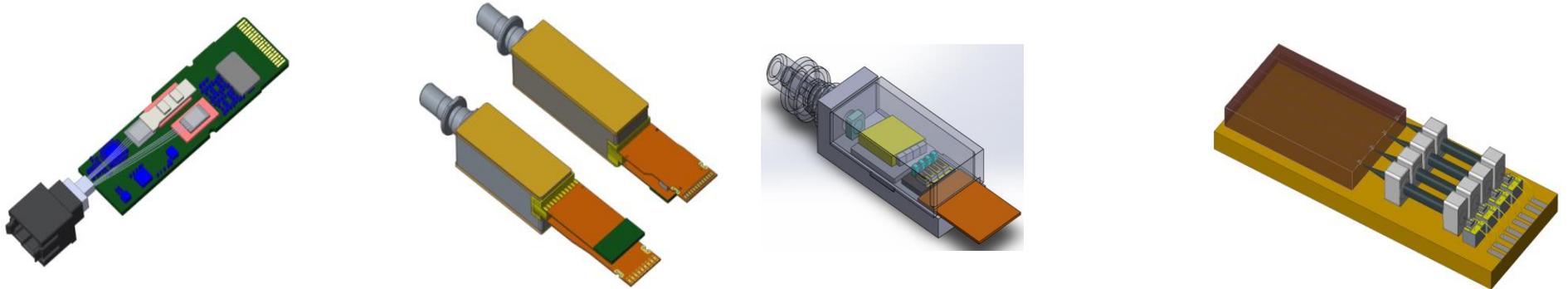
- Optical assembly
- Mechanical/Electrical integration
- Verification service
 - O/E Characterization
 - Data link test
 - Reliability test



技術及封裝能力(二)

- Micro-optics light path simulation and design, Hermetic/non-hermetic assembly technology

- Waveguide Optical Coupling technology



— Technology application:

- Eutectic process
- High precision die attach (accuracy +/- 5 um @3 σ , +/- 0.1 degree @3 σ)
- Wire bonding
- CoC Burn-in
- High precision passive mount (accuracy +/- 1um @3 σ , +/- 0.1 degree @3 σ) for optics
- Lens & FA coupling technology
- Fiber Array unit attachment (accuracy +/- 0.5um @3 σ)
- Flip-chip die bonding (accuracy < 1um @3 σ)
- Hermetic sealing
- Laser coupled welding



財務資訊

單位：新台幣百萬元

1,200

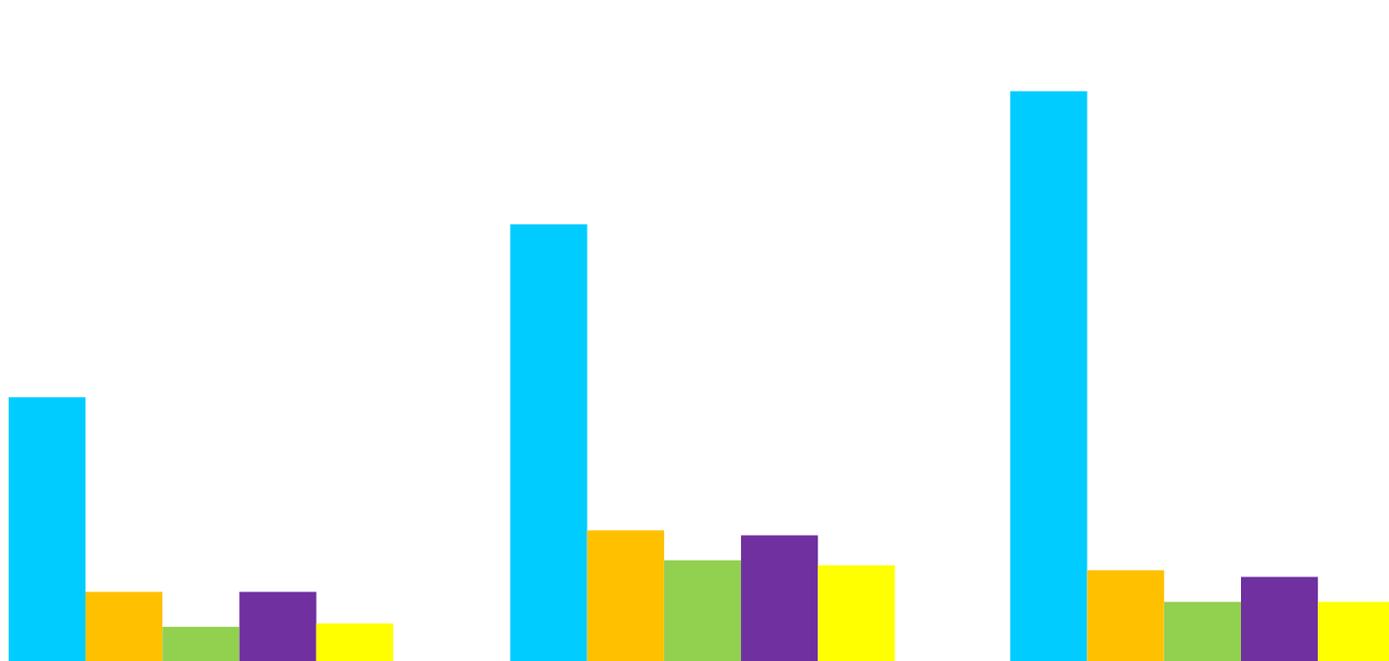
1,000

800

400

200

-



2022 H1

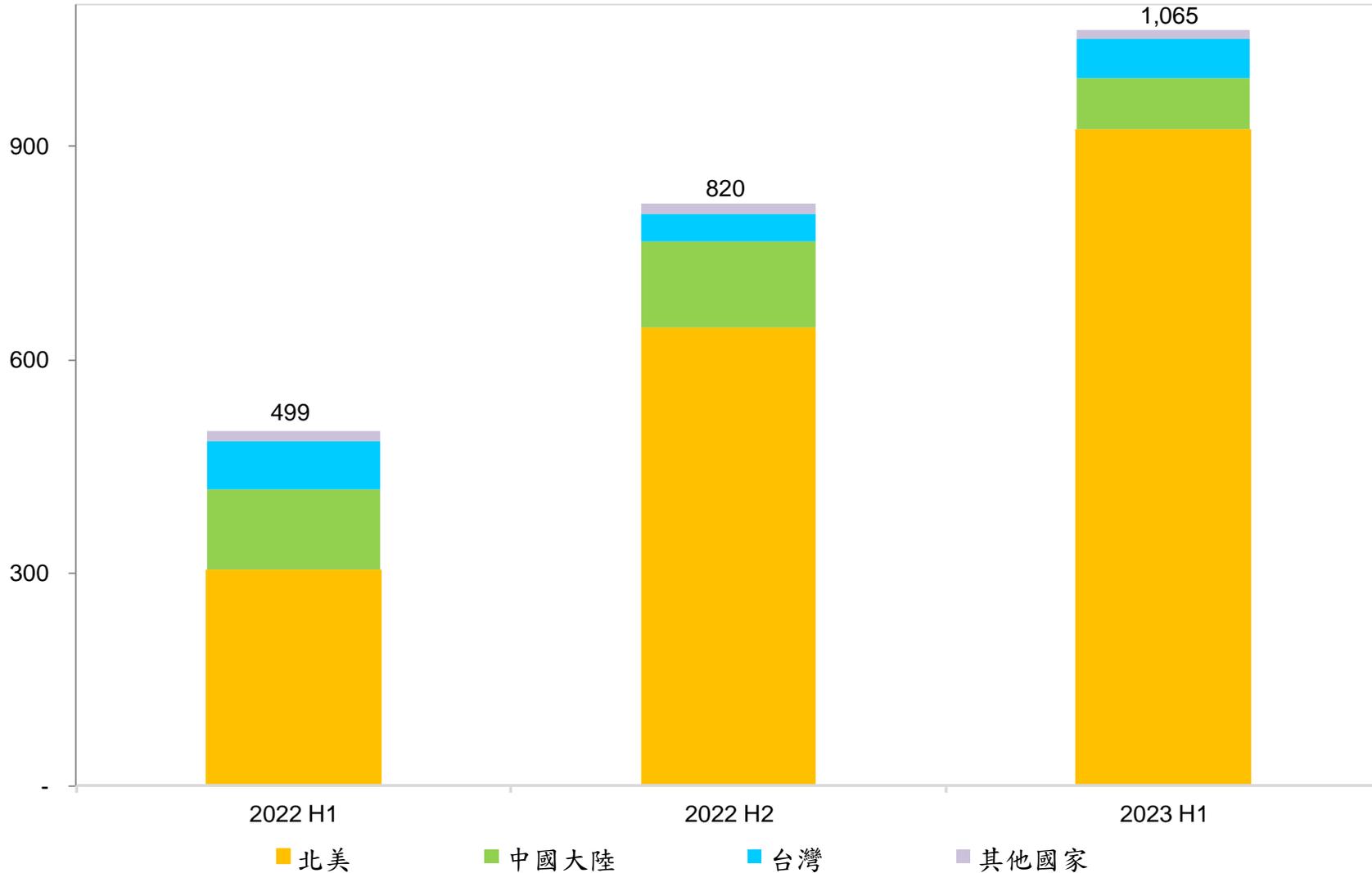
2022 H2

2023 H1

■ 營業收入	499	820	1,065
■ 營業毛利	141	256	182
■ 營業淨利	75	198	121
■ 稅前、息前、折舊攤銷前獲利	141	245	168
■ 本期淨利	81	189	122

營業收入-地區別

單位：新台幣百萬元



損益表

單位：新台幣百萬元	2022	2023		季變化	年變化	2022	2023	年變化
	Q2	Q1	Q2	QoQ	YoY	Q1~Q2	Q1~Q2	YoY
營業收入	296	487	578	18.7%	95.3%	499	1,065	113.4%
營業毛利	111	72	110	52.8%	(0.9%)	141	182	29.1%
推銷費用	2	2	2	-	-	6	5	(16.7%)
管理費用	12	15	15	-	25.0%	24	30	25.0%
研發費用	17	14	13	(7.1%)	(23.5%)	36	26	(27.8%)
營業費用	31	31	30	(3.2%)	(3.2%)	66	61	(7.6%)
營業淨利(損)	80	41	80	95.1%	-	75	121	61.3%
營業外收支	3	(1)	2	-	(33.3%)	6	1	(83.3%)
稅前、息前、折舊攤銷前獲利	113	65	103	58.5%	(8.8%)	141	168	19.1%
本期淨利	83	40	82	105.0%	(1.2%)	81	122	50.6%
基本每股盈餘(元)	0.63	0.30	0.62	106.7%	(1.6%)	0.62	0.93	50.0%

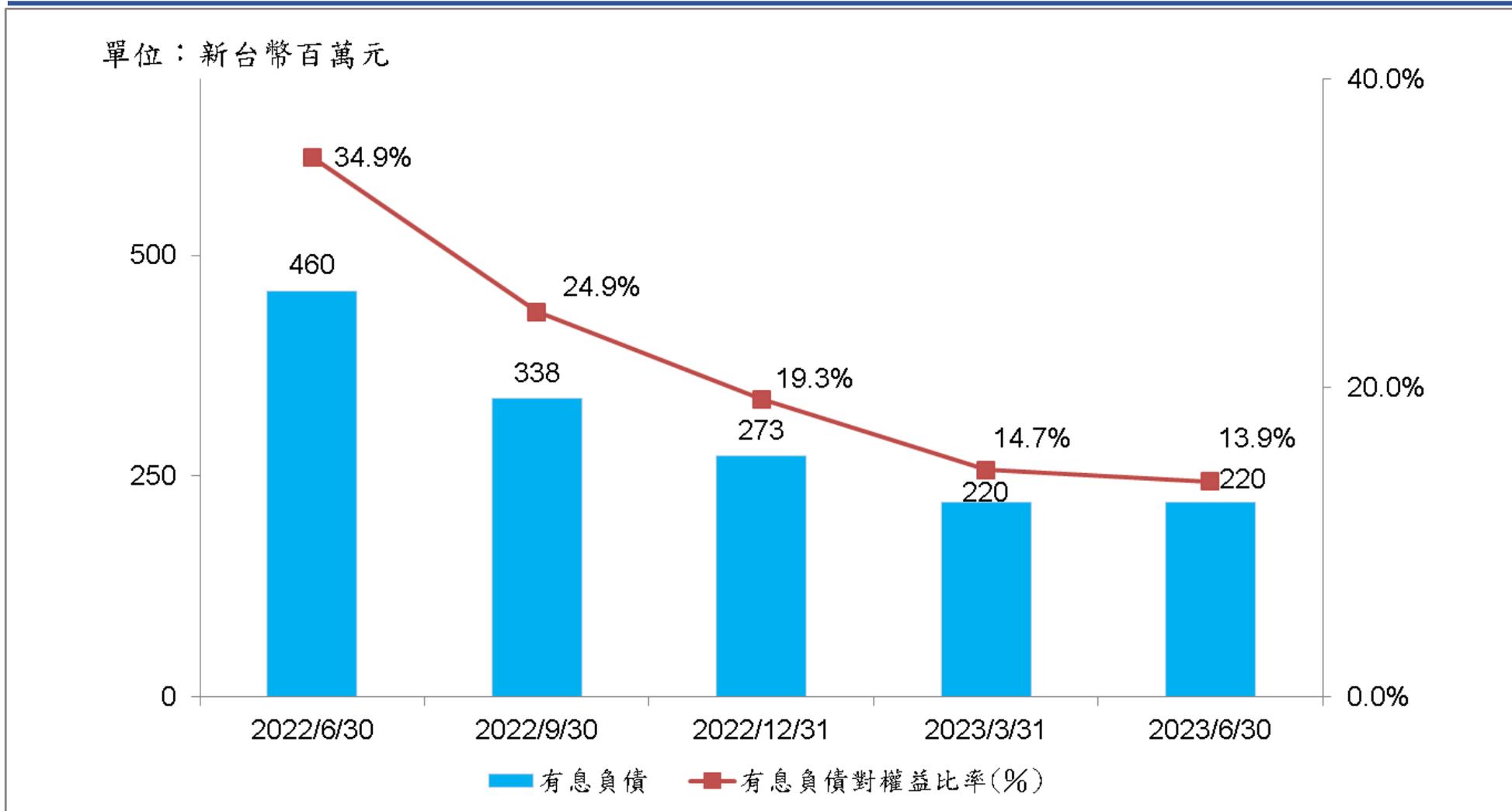
資產負債表

單位：新台幣百萬元	2022/6/30		2022/12/31		2023/6/30	
現金及約當現金	458	22.2%	484	23.3%	508	24.3%
應收票據及帳款淨額	273	13.2%	254	12.3%	306	14.7%
存貨	321	15.5%	467	22.5%	406	19.4%
其他流動資產	23	1.1%	32	1.5%	16	0.8%
流動資產	1,075	52.0%	1,237	59.7%	1,236	59.2%
不動產、廠房及設備	770	37.3%	706	34.1%	659	31.6%
公允價值衡量之 金融資產(FVOCI)	218	10.6%	126	6.1%	175	8.4%
其他非流動資產	3	0.1%	4	0.2%	18	0.9%
非流動資產	991	48.0%	836	40.3%	852	40.8%
資產總額	2,066	100.0%	2,073	100.0%	2,088	100.0%
流動負債	428	20.7%	436	21.0%	287	13.7%
非流動負債	320	15.5%	220	10.6%	221	10.6%
負債總額	748	36.2%	656	31.6%	508	24.3%
普通股股本	1,324	64.1%	1,324	63.9%	1,323	63.4%
資本公積	4	0.2%	4	0.2%	4	0.2%
保留盈餘	(80)	(3.9%)	109	5.3%	224	10.7%
其他權益	70	3.4%	(20)	(1.0%)	29	1.4%
權益總額	1,318	63.8%	1,417	68.4%	1,580	75.7%
每股淨值(元)	9.96		10.70		11.94	

現金流量表

單位：新台幣百萬元	2022 Q1~Q2	2023 Q1~Q2
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利	82	122
折舊及攤銷費用	56	46
其他非現金之收益費損調整	2	45
資產/負債變動數	(100)	(117)
營業活動之淨現金流入(流出)	40	96
投資活動之現金流量		
取得不動產、廠房及設備	(3)	(19)
處分不動產、廠房及設備	3	0
其他投資活動	(3)	0
投資活動之淨現金流入(流出)	(3)	(19)
融資活動之現金流量		
短期借款變動	52	(53)
融資活動之淨現金流入(流出)	52	(53)
本期現金及約當現金增加(減少)數	89	24
期初現金及約檔現金餘額	369	484
期末現金及約檔現金餘額	458	508
自由現金流量	37	77

財務結構



註：有息負債對權益比率：有息負債／股東權益

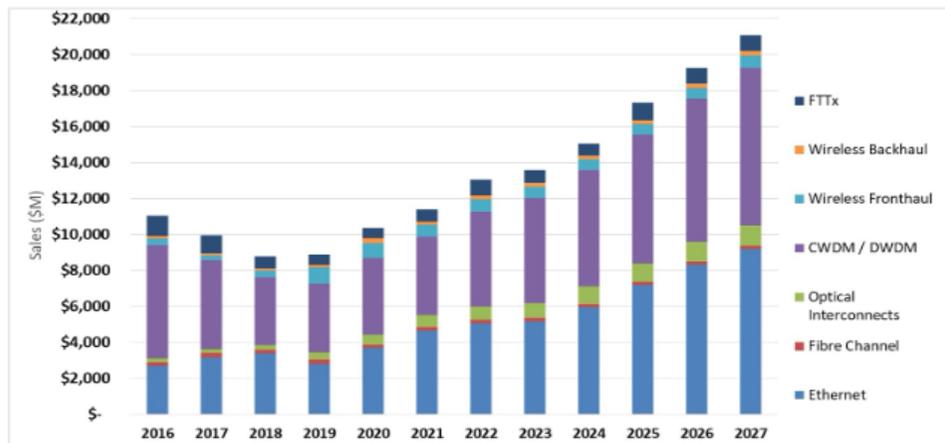
重要財務比率

單位：%；天數	2022/6/30	2022/12/31	2023/6/30
流動比率	251.2%	283.7%	430.7%
負債比率	36.2%	31.6%	24.3%
CCC Days	69	60	89
存貨週轉天數	70	71	90
應收帳款週轉天數	39	30	48
應付帳款週轉天數	40	41	49

市場趨勢及未來展望

- ▶ LIGHTCOUNTING 市調機構預估 2022年至2027年 光通訊產業銷售額年複合成長率成長為11%，相較去年的預估差異不大。另外原本在 Y2023上半年放緩的趨勢，也因為AI的需求而在Y2023下半年持續成長至Y2025。
- ▶ Yole 市場調查資料顯示，預估全球2026年數據中心銷售額為151億美元，到2032年數據中心銷售額達到223億美元，其中CPO在2026年後有明顯成長的趨勢。
- ▶ 根據各大數據中心服務提供者表示，插拔式的光模塊在1.6T甚至是3.2T的速率下，依然是不會被CPO全面取代，未來的3~5年會有各自的發展。

Global sales of optical transceivers 2016-2027 by segment

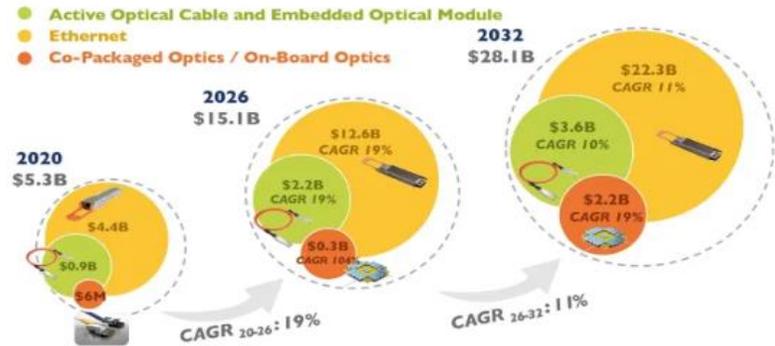


Source: LightCounting

資料來源：LIGHTCOUNTING

2020 vs. 2026 vs. 2032 datacom optics revenue growth forecast

(Source: Co-Packaged Optics for Data Centers 2022 report, Yole Développement, 2022)



YOLE
Développement

© 2022 | www.yole.fr - www.lightcounting.com

資料來源：Yole

Q & A

THANK YOU